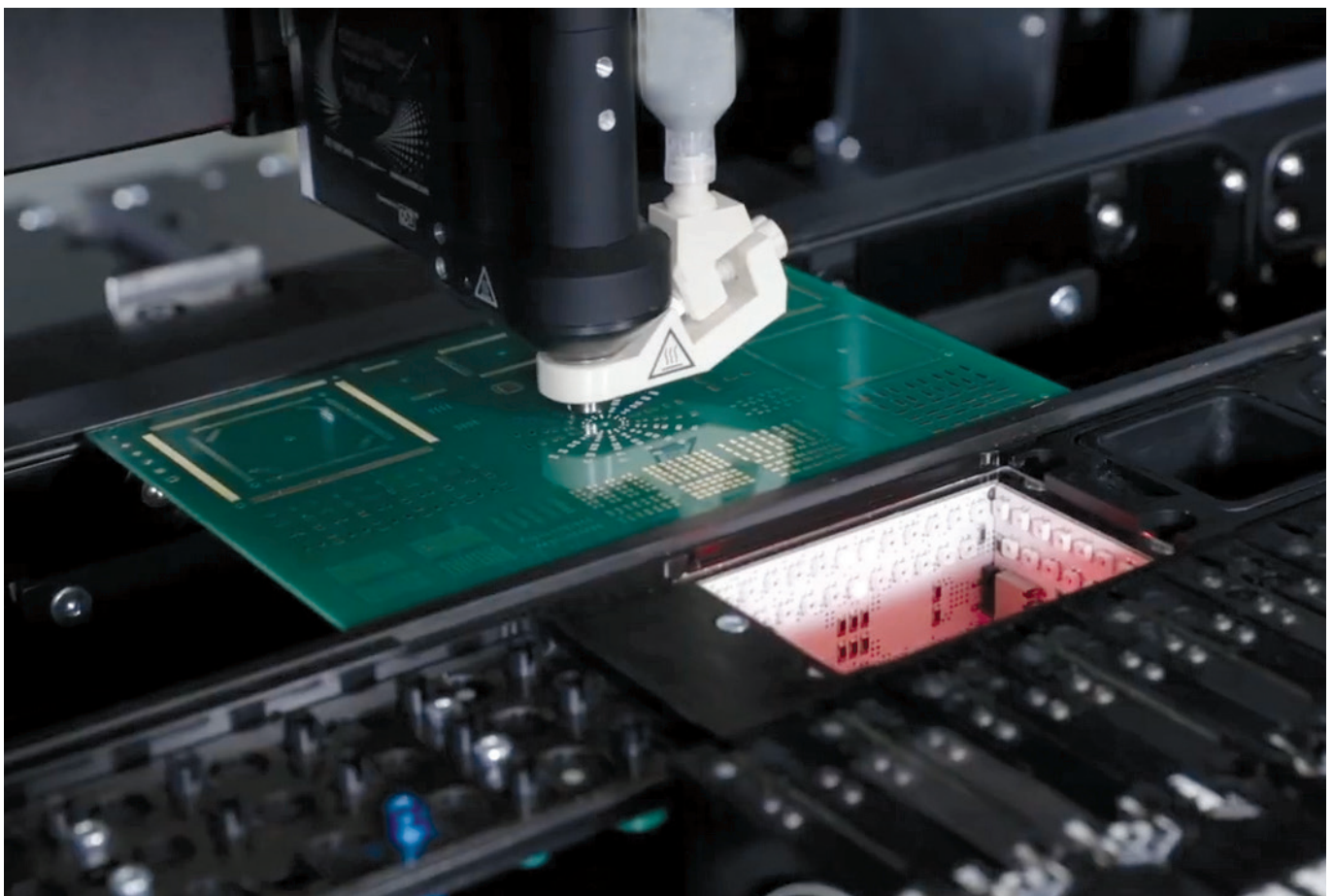


新闻新闻新闻

VERMES Microdispensing与GENMA合作推出超小胶点锡膏喷射方案

VERMES Microdispensing是创新型微点胶系统开发和制造的市场领导者，GENMA是国际领先的高质量焊锡膏生产商，双方近期的合作将实现在电子制造中运用超少量锡膏进行快速、稳定点胶的新应用。

锡膏喷射的主要应用之一是PCB (Printed Circuit Board印刷电路板) 中电子组件的安装。另一个主要的应用领域是模块封装。这两个应用过程都要求最高的点胶喷射质量和最稳定的工艺条件。



市场上很多可用的系统都基于旧技术，这些技术已经不能满足当今市场对更高运行速度和更微小的胶点尺寸的要求。而VERMES Microdispensing微点胶系统则是基于喷射阀，可以实现点胶介质无接触、高速和高精度的点胶应用。

“GENMA一直在为我们的客户寻求改进和新技术解决方案。通过与VERMES Microdispensing的合作，我们现在可以提供优秀的锡膏解决方案，解决现存的技术挑战。GENMA的winDot锡膏可以安全地应用在小至130 μm的自动化点胶生产中，” GENMA欧洲CEO Stefan Komenda说道。

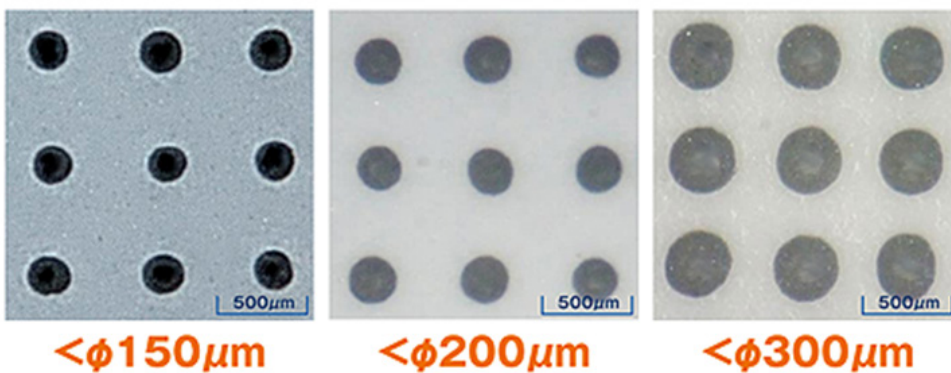
“VERMES Microdispensing微点胶系统MDS 1560的优势是基于我们革新性的驱动技术-DST (Dynamic Shockwave Technology动态震波技术)，结合GENMA winDot锡膏一起使用，即使在喷射超小胶点的情况下，也可以为我们的客户提供最佳的锡膏点胶结果，” VERMES Microdispensing CEO Juergen Staedtler补充道。

VERMES Microdispensing微点胶系统MDS 1560可以轻松地集成到很多机器平台，如，点胶机器人和丝网印刷机。

高端设计和增加的功能要求电子产品越来越小。新的VERMES MDS 1560点胶系统具有优化的点胶性能，结合GENMA的winDot锡膏，可以在高速、稳定的过程中进行小胶点喷射。除速度和胶点大小外，可靠性尤其重要。新的喷射工艺提供了一种可持续喷射最优结果的点胶方案。该阀可以连续喷射超过一百万个胶点，无需操作员的干预。

在电子设备生产中，此方案可以轻松地进行最小胶点的锡膏点胶喷射，从而提高电路板上的胶点密度。GENMA winDot锡膏可以被喷射到当前使用的最小芯片组件焊盘上，其编号为01005。

在原型制造和小规模生产中，VERMES Microdispensing 微点胶系统MDS 1560与GENMA winDot锡膏相结合，比丝网印刷的生产率高得多。



用VERMES MDS 1560 微点胶系统和GENMA winDot锡膏喷射的各种不同的胶点尺寸。



200 μm的小胶点可被应用在模块封装中



除丝网印刷外还有小面板点胶喷射

在大规模生产中，该方案是填充或额外添加锡膏补给的一个理想补充。

在无法打印少量锡膏的地方，如，柔性电路板和3D-MID（3-Dimensional Molded Interconnected Devices production 三维模塑互联设备），此系统方案提供了最快、最精准的锡膏涂覆方式。

毫无疑问，此喷射技术比针头式点胶和针转印更快速，并且能实现更精准的点胶结果。

由于此喷射技术具有更高的精准度，因此与当前使用的锡膏涂覆方式相比，可以显著提高生产率。小胶点加上极高的可靠性和高速度，还为模块封装过程提供了很大的优势，例如PoP模块（Package on Package层叠封装）、CSP模块（Chip Scale Packages芯片级封装）、3D印刷电路板以及射频盾板的组装。

VERMES Microdispensing GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen | Germany

+49 (0) 8024 6 44 0 | +49 (0) 8024 6 44 19

sales@vermes.com | www.vermes.com

Germany
+49 (0)8024 644 - 0
info@vermes.com

China
+86 (0)592 7257233
info@vermes.com

USA
+1 408 520-2555
america@vermes.com

Korea
+82 (0)32-246-1500
korea@vermes.com

Malaysia
+60 4 358 0996
info@vermes.com

